

システム オン シリコン セルベースICとチップ
System-on-silicon cell-base IC and its chip

システム オン シリコン セルベースIC

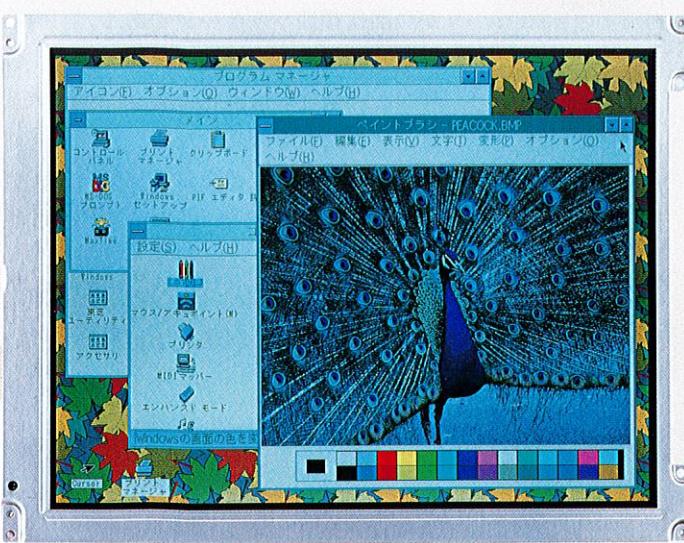
0.3μmCMOSプロセス技術を用いたセルベースICの新シリーズTC220C/Eを開発した。

電源電圧は3.3V、最大使用可能ゲート数は1.87Mゲート、ゲート当たりの遅延時間は0.14nsである。

また、異種デバイスの混載技術を開発し、論理LSIに多ビットDRAMコア、高速・高精度のADコンバータ／DAコンバータ、EEPROMなどの混載が可能である。

RAC (Rambus™ ASIC Cell) など豊富な高機能マクロセルを充実させるとともに、設計環境を整備することで、システム オン シリコンの実現を図っている。

関係論文：東芝レビュー、50、12、pp.879-882



カラーTFT液晶表示モジュール LTM12C013
LTM12C013 color TFT-LCD module

対角31cm(12.1型) XGA対応 カラーTFT液晶表示モジュール

ラップトップパソコン用に、対角31cm(12.1型)XGA(1,024×768画素)対応、カラーTFT液晶表示モジュールLTM12C013を開発した。

このモジュールでは、小型化と高輝度化を、次の技術を用いて実現した。

(1) スリムTAB(Tape Automated Bonding)-ICの採用

(2) 広視角特性の維持と高輝度化を考慮した最適なレンズシートの採用

(3) 2灯式バックライトの採用

この結果、外形寸法は横285mm×縦218mm×厚さ15mm、表示輝度は100cd/m²となった。

これによりラップトップパソコン以外のデスクトップモニタ、一般産業用表示機器などへも応用分野を拡大することができた。

X線診断用JシリーズI.I.



高いX線検出効率とコントラスト特性をもつJシリーズX線イメージインテンシファイア(I.I.)を、視野サイズが10cmから31cmのものまで商品化した。

JシリーズI.I.は入力窓に入力蛍光体を直接形成し、入力窓部でのX線の散乱吸収を減少させた。その結果、量子検出効率が70%、10mmコントラスト比が23cmのI.I.では24に、31cmのI.I.では20まで向上した。これは低コントラスト被写体識別限界能や観察者受動特性(ROC)解析でも実証された。

JシリーズI.I.は最近発達してきたIVR(Interventional Radiology)にも優れた性能を発揮する。

関係論文：東芝レビュー，50，10，pp.791-794

AIN-QFPの製品化

AIN(窒化アルミニウム)をベース基板に使用したQFP(Quad Flat Package)を製品化した。

この製品は、AINの高熱伝導性(170W/mK)と、熱膨張係数がSi半導体素子に近似しているという特長を生かした、低熱抵抗、かつ高信頼性パッケージである。

焼結助剤組成、成形、脱脂・焼成、表面処理などの条件の最適化により、ベース基板の量産プロセスを確立した。

この製品の寸法精度および気密封止信頼性は、従来のアルミナベースQFPと同等である。

リードフレームには、片面Al蒸着した42アロイを採用し、高速素子に対応している。

